

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年2月9日(09.02.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/013224 A1

- (51) 国際特許分類:
C08G 73/10 (2006.01) C08L 79/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/022278
- (22) 国際出願日: 2022年6月1日(01.06.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-127039 2021年8月3日(03.08.2021) JP
- (71) 出願人: 日本化薬株式会社(NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 西村 謙吾 (NISHIMURA Kengo); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP). 佐々木 智江(SASAKI Chie); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP). 田中 竜太郎(TANAKA Ryutaro); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP). 長嶋 憲幸(NAGASHIMA Noriyuki); 〒1158588 東京都北区志茂三丁目3番12号 日本化薬株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 上村 陽一郎(KAMIMURA Yoichiro); 〒1010052 東京都千代田区神田小川町3丁目11 E/Frontビル9階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: POLYIMIDE RESIN, RESIN COMPOSITION COMPRISING POLYIMIDE RESIN AND CURED PRODUCT THEREOF

(54) 発明の名称: ポリイミド樹脂、該ポリイミド樹脂を含有する樹脂組成物及びその硬化物

(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing: a resin material which has a novel structure and can be suitably used in a printed wiring board; and a resin composition comprising this resin material, a cured product of which has excellent substrate adhesion, mechanical properties, heat resistance, lamination properties, and dielectric properties after moisture absorption. The present invention pertains to a polyimide resin that is the product of a reaction between an imidized compound (P) of a polyamic acid resin, said polyamic acid resin being a copolymer of amino compounds (A) containing an aminophenol compound (a1) having at least two amino groups per molecule, an aliphatic diamino compound (a2) having 6-36 carbon atoms and an aromatic diamino compound (a3) having no phenolic hydroxyl group and a tetrabasic acid dianhydride (B), with a compound (C) having a functional group that can react with a phenolic hydroxyl group and an ethylenically unsaturated double bond group.

(57) 要約: 本発明の課題は、プリント配線板に好適に用い得る新規構造の樹脂材料、及び該樹脂材料を含有し、その硬化物は基材接着性、機械特性、耐熱性、ラミネート性、吸湿後の誘電特性に優れる樹脂組成物を提供することである。本発明は、一分子中に少なくとも二個のアミノ基を有するアミノフェノール化合物(a1)、炭素数6乃至36の脂肪族ジアミノ化合物(a2)及びフェノール性水酸基を有さない芳香族ジアミノ化合物(a3)を含むアミノ化合物(A)と四塩基酸二無水物(B)との共重合物であるポリアミミック酸樹脂のイミド化物(P)と、フェノール性水酸基と反応し得る官能基とエチレン性不飽和二重結合基を有する化合物(C)との反応物であるポリイミド樹脂に関する。

[続葉有]

WO 2023/013224 A1

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）